

高精度実装機

高精度ボンダー:AFMシリーズ (熱/超音波接合,熱共晶, TC, C4, DAF, 転写, 他)

Micro-LED, Mini-LED/5G/IoT市場に着目した豊富な製品構成です。

業界リーダーとして、高生産性と高信頼性の両立を追求し、
多種・多様な接合工法に対応します。

最終製品

- スマートフォン、タブレット、PC、自動車、照明器具、TV
- ウェアラブル機器、ヘルスケア、その他

対象デバイス

- 各種LED(高輝度,UV,Micro,Mini等)、LD、CMOSセンサ、SAW、TCXO
- 各種センサ、AOC、RFモジュール 他 多数

特長

- 実装スピード(Max) 0.72 sec/点(プロセス時間 含)
- 実装精度(Max) $\pm 2\mu\text{m}/3\sigma$
- 各種検査機能 前検査・後検査
- 大型基板対応 540 x 450 mm
- 任意角度実装 0, ± 45 , ± 90 , 180°
- 各種転写(Stamp & Laser Transfer)
- クリーン度 クラス10
- Face Down/Face Upの兼用
- フラックス転写、ディスペンスヘッド搭載

概略仕様

- 対象製品
 - ・ チップ: Max 12 インチウエハ 他
 - ・ 基板: Max 12 インチウエハ 他
- 各種超音波ホーン保有(片持ち、両持ち)
- 熱圧着ヘッド(共晶含む)
- 実装前後検査機能(PBI)
- 樹脂塗布(フラックス、シリコン等)
- 豊富な経験による接合プロセス提案

